



深圳长城开发科技股份有限公司

2018 年半年度报告摘要

2018 年 08 月

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编号：2018-037

深圳长城开发科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	深科技	股票代码	000021
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李丽杰		
办公地址	深圳市福田区彩田路 7006 号		
电话	0755-83200095		
电子信箱	stock@kaifa.cn		

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	8,264,991,735.06	7,186,882,218.68	15.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	171,778,212.80	307,439,494.71	-44.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,505,156.22	60,747,762.44	-59.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	140,360,575.28	305,441,429.23	-54.05%
基本每股收益（元/股）	0.1168	0.2090	-44.11%
稀释每股收益（元/股）	0.1168	0.2090	-44.11%
加权平均净资产收益率	2.89%	5.68%	-2.79%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	14,882,434,069.89	16,599,483,730.27	-10.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,873,733,046.31	5,856,692,553.42	0.29%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	110,762	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股 比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状 态	数量
中国电子信息产业集团有限公司	国有法人	44.51%	654,839,851			
博旭（香港）有限公司	境外法人	7.25%	106,649,381			
柴长茂	境内自然人	1.48%	21,822,397			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.33%	4,899,064			
郝双刚	境内自然人	0.29%	4,288,001			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.27%	3,993,100			
杨小刚	境内自然人	0.20%	2,988,900		质押	781,600
周淑芳	境内自然人	0.20%	2,986,400			
龙力控股有限公司	境外法人	0.18%	2,598,900			
董燕华	境内自然人	0.17%	2,497,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一、第二大股东与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人，上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东柴长茂通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 21,822,397 股，股东郝双刚通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,718,001 股，股东杨小刚通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,924,000 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年上半年，新兴经济体经济复苏遭遇挑战，地区间贸易摩擦升级，全球经济遇到的风险和困难逐步增多。

面对复杂的国内外形势，公司紧紧围绕战略发展规划，以坚持稳健发展为前提，积极贯彻落实年度经营计划目标。作为全球领先的电子产品制造服务（EMS）专业提供商，深科技将在现有EMS核心业务基础上，通过推进智能制造持续优化先进制造管理体系，夯实公司EMS核心能力，并在保持现有计算机与存储及其相关产业制造服务优势的同时，着力提升管理和运营效率，不断发展壮大通讯与消费电子、医疗设备以及自主产品等业务。同时，通过自主创新与投资并购等方式，优化产业结构，加大力度布局集成电路半导体封装与测试和新能源汽车电子等战略性新兴产业，力争实现经营业务的稳步增长。

报告期内，公司日本封测子公司继续加大半导体封测技术的研发力度，向产业链上游延

伸，打造核心技术优势；美国新产品导入子公司为客户提供实时的技术支持，助推公司业务发展迈向新台阶。公司贴近客户布局产业基地，在马来西亚、菲律宾等国家都设有工厂。目前公司已建有深圳、苏州、惠州、东莞、成都、美国、马来西亚、菲律宾等产业基地，其中重庆新型电子产业园占地700余亩，报告期内已取得建设用地规划许可证及国有土地使用证，各项前期招标工作现正有序推进。公司海内外产业基地的布局，为进一步开拓海内外市场奠定了坚实基础。

报告期内，深科技城已完成商业品牌落位，未来将建成以“科技、研发、金融、专业服务”为核心产业聚集的城市创新综合体，目前一期项目工程进展顺利，计划将于年底完成项目工程桩的施工，并于2020年底完成一期项目。深科技城项目在满足自用的前提下将以出租为主，届时将为公司带来更为充沛的现金流。

报告期内，公司实现营业收入82.65亿元，同比增长15%；实现归属于上市公司股东的净利润1.72亿元，同比降低44.13%。

1) 集成电路相关产品

为进一步推动公司产业链向高附加值的中上游存储芯片封装测试产业链延伸，向封装测试等核心技术领域产业转型升级，公司积极布局集成电路半导体封测产业，目前公司封装测试产品主要包括DDR3、DDR4内存颗粒，eMCP、USB、SSD闪存芯片以及Fingerprint指纹芯片等，并具备wBGA、LPDDR、eMCP、SSD、POP、LGA、TSOP等封测技术，报告期内，公司新建成SOP、QFN等产品线。为把握国内外存储芯片发展机遇，满足市场对高速、低功耗、大容量记忆芯片封装需求，公司已着手推动新产品的应用，以不断增强公司的核心竞争力，实现公司的可持续发展。

目前，公司为全球最大的内存模组生产基地之一，与业内国际化大客户形成战略合作伙伴关系，能够根据客户的芯片和应用要求，设计定制化的专用产品。产品主要应用于计算机、网络通讯消费电子及智能移动终端、工业自动化控制、汽车电子等电子整机和智能领域。

报告期内，公司与移动终端指纹识别芯片封测方面的客户合作稳定，但因人脸识别技术等更迭速度加快，将在一定程度上影响该业务的发展。同时，随着LED芯片制造行业景气度的持续提升，公司继续扩大为LED芯片厂商提供点测分选的生产能力，运营质量进一步提高。报告期内，液晶面板背光及智能穿戴技术发展迅速，公司提前布局，已对Mini-LED倒装芯片的测试封装技术开展研发工作，有望为公司带来新的利润增长点。

在存储产品领域，目前产品主要包括内存模组、USB存储盘（U盘）、Flash存储卡、SSD等存储产品，公司采用行业领先的生产制造工艺，为客户提供包括SMT制造，测试，组装，

包装及分销服务，提供存储集成电路设计制造，封测的配套业务。

《国家集成电路产业发展推进纲要》中指出集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，公司将以此为契机，紧紧围绕集团布局，把握发展机遇，为国家集成电路产业做出更大贡献。

2) 自主研发产品

公司自主研发产品主要包括计量系统产品、自动化设备产品、工业物联网产品等业务。

在计量系统业务领域，公司主营智能水、电、气等能源计量管理系统的全套解决方案及配套产品和服务。报告期内，计量系统业务经营稳定，营业收入同比增长30%以上。在技术积累储备方面，公司推出NB IoT（窄带物联网）应用模组，该产品主要应用于电、水、气、热表的物联网改造；上半年通过与知名通讯运营商进行水表、电表的物联网测试，获得市场高度认可；全系列的电力载波方案产品成功获得G3-PLC认证；与全球顶尖的云服务商合作，为电力客户提供计量系统云服务，实现云计算、大数据、智能化三者相结合的整体解决方案，并已批量部署；公司智能电表产品到系统达到了银行级的安全加密水平，实现了DLMS Suite1/2；公司产品及安全管理体系顺利通过了英国的CPA认证，计量业务的信息安全管理水平已达到业界顶尖水准。在市场拓展方面，顺利通过德国及英国的全套产品认证测试，为进一步开拓市场奠定了坚实基础；在瑞典市场为客户提供国际一流的 RF Mesh（无线主网）网络方案，赢得瑞典第二代智能电表项目中最大的业务合同。未来公司将继续提高技术研发实力，为市场提供更专业、更经济的智能用电产品及系统解决方案。

在自动化设备领域，在满足公司内部需求的同时，积极开拓外部市场，不断加强在自动化产品领域的技术创新和资源整合，为客户提供智能高效的自动化生产线及自动化解决方案，目前该业务已形成高精密自动装配、自动点胶、自动贴标、自动化线体以及非标自动化五个产品系列，报告期内，光学字符识别自动化研究、3G硬盘PCBA SMT后段自动化生产线等新技术项目成功立项，未来公司将运用全面管理体系集成供应商数据，实现互联互通智能应用，打造出一整套自我完善的数字化智慧工厂管理系统。

在工业物联网领域，公司设有专业团队专注于物联网产品的研发和应用，现拥有实时静电防护监控系统（KEDAS）、工业物联网系统（iDAS）智能工地管理系统（iFOS）、智能离子风机等多项自主研发的工业物联网专利和产品。报告期内，公司在已有技术基础上，重点研制开发工业物联网核心软硬件产品及平台技术，目前已成功开发出工业物联网云平台，并通过物联网在管理和生产中的应用，进一步提高了各类智能产品的质量和可靠性，生产管理效率不断提高。未来公司计划将物联网技术逐步由生产制造向对客户服务推进，为客户提供相

应的管理运营能力和服务，成为产品价值链中的更重要的一环。

3) 硬盘相关产品

公司硬盘相关产品包括硬盘磁头、硬盘电路板和盘基片。

近年来固态硬盘发展相对迅速，正逐渐取代个人台式机和笔记本中的机械硬盘，市场份额的持续扩大致使传统硬盘市场出货量继续萎缩，受其影响，公司的硬盘磁头及相关产品业务也有不同程度的下降。但服务器和企业级应用上，机械硬盘在数据安全和容量需求领域仍然有高容量和价格优势，因此机械硬盘依然会是未来数据的主要载体，各硬盘厂商都在研究新技术提高机械硬盘存储密度，公司也在不断优化工艺水平提高工艺制造精度，订单呈平稳低速递增状态。报告期内，公司以客户为导向，积极调整产品结构，引入存储服务器、固态硬盘等新业务的生产，延伸业务产业链，并通过内部管理提升，实施精益生产以及进一步提升全产线自动化率等措施，降本增效，保持该业务的盈利能力。

4) 电子产品制造服务

电子产品制造业务是指公司为客户提供物料采购、SMT贴片、整机组装、测试、物流配送等环节的电子产品制造服务，主要包括通讯与消费电子、医疗产品、商业与工业等业务。

在通讯与消费电子领域，全球智能手机市场销售数字趋缓，国产智能手机出货量低于去年整体水平。近年来我国劳动力成本逐年上升，作为制造型企业，用工成本的增加已对企业生产经营造成较大程度的影响，2018年上半年通讯业务出现亏损。

在医疗产品业务领域，公司拥有通过广东省医疗器械质量监督检验所检测的无菌净化生产车间，报告期内，公司深圳工厂和苏州工厂都顺利获得国家食品药品监督管理总局（CFDA）颁发的产品许可证及生产许可证，未来公司将加大“家用医疗产品”及“便携式医疗器械”的研发投入，并对现有产品进行升级，以提升公司未来在该领域内的市场份额和行业影响力。为进一步提升在医疗产品领域的技术实力及生产能力，将在多领域导入智能系统，以交付更有效更安全的产品。

在其他电子产品方面，报告期内，公司智能运通事业部的消费级无人机业务开展顺利，并利用现有客户优势积极跟进和导入工业级无人机等产品；公司机器人业务顺利完成试产并获得客户高度认可，预计下半年进入小量生产；汽车电子业务开拓成果显著，智能传感器业务实现小量生产，未来有望打开业务成长空间。

5) 新能源业务

在动力电池领域，随着新能源汽车需求量的不断提高，动力电池需求也节节攀升，公司目前已成功开拓新能源汽车动力电池包业务，并预计今年下半年实现量产。动力电池包是新

能源汽车核心能量源，为整车提供驱动电能，我国动力电池生产规模正在逐年增长，预计到2019年，动力电池PACK行业将形成千亿级市场，市场前景广阔。公司参股振华新材（原新三板，拟转板IPO上市），有望在新能源汽车电子方面建立产业协同的合作关系，通过发挥产业链优势，实现双方资源共享、优势互补，共同做大做强新能源汽车业务。

在超级电容领域，公司凭借在该行业多年的积累，已与国际顶级超级电容厂商形成长期稳定的合作关系，已累计出口1400万套超级电容模组。公司具备各类型超级电容整套模组制造解决方案，主要客户为Maxwell和Tecate。为更好的完善供应链，于2018年初开始导入单体制造生产线，公司未来将积极布局超级电容相关技术工艺的提升和产业化，为公司在该领域打开成长空间。

在LED领域，开发晶作为LED行业的龙头企业之一，也是公司在LED产业链的核心平台。2017年底为进一步做大做强LED产业，开发晶引进无锡国联系增资扩股，目前业务范围涵盖LED外延片、芯片、封装模组、照明应用、汽车照明、小间距显示器件等全产业链环节，具有上下游协同开发、快速响应、整体供应链成本低的优势。报告期内，开发晶通过整合全球资源，将英特美荧光粉与普瑞封装产品相互结合，强化了LED照明品牌配套的价值链竞争力。未来开发晶将以市场需求为导向，培育新业务机会，为公司未来发展提供新的增长点。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二零一八年八月十六日